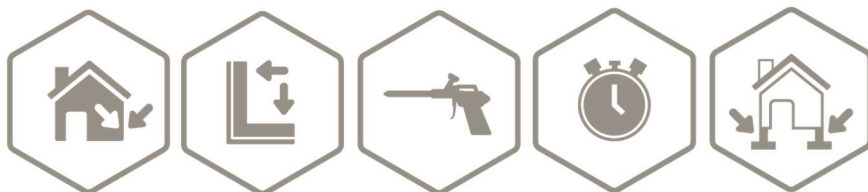


IZOCHEM KS

KLEJ PU DO ELEWACJI I FUNDAMENTÓW



SPECYFIKACJA:
ITB-KOT-2018/0487

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
750 ML



OPIS PRODUKTU:

IZOCHEM KS niskoprężna piana poliuretanowa stosowana do mocowania płyt ocieplających przy ocieplaniu budynków metoda bezspoinową (ETICS) oraz ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków.

ZALETY:

- umożliwia szybkie wykonanie prac (wstępne utwardzenie po 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach*)
- wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży bitumicznych (bezpoczątkowników mas PMBC, pap zgrzewalnych) oraz wszelkich podłoży mineralnych
- bardzo wydajny (średnia wydajność ok. 12 m² z puszki)
- stosowany w szerokim zakresie temperatur, szczególnie polecany w okresach chłódów jesienno-wiosennych
- jednoskładnikowy, niskoprężny
- łatwy i wygodny w użyciu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- klejenie płyt styropianowych EPS i XPS do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)
- klejenie płyt styropianowych EPS i XPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków
- do klejenia kasetonów styropianowych, paneli ściennych, montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Płyty EPS i XPS powinny mieć proste krawędzie. Podłoże przygotowane pod klejenie płyt powinny być wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu nie może przekraczać – 4mm i + 2 mm. Pomiar odchylenia należy dokonywać łatą o długości 2 m z dokładnością do 1 mm. Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane, wilgoć odparowana z całej grubości. W przypadku podłoży bitumicznych (o nieznanach parametrach) warto przeprowadzić próbę przyczepności tj płytę z naniesionym klejem przykleić do podłoża, a następnie po ok. 2 h (czas minimalny) wykonać próbę zerwania. W systemie ETICS przed przystąpieniem do klejenia płyt ocieplających należy zamocować listwy startowe, a w systemach izolacji fundamentowych należy je wesprzeć na odsadźce ławy fundamentowej. Jeśli to możliwe podeprzeć je w czasie wiązania piany. Płyty termoizolacyjne hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować np. papierem ściernym

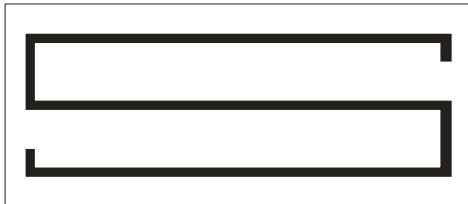
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Przed przystąpieniem do klejenia należy intensywnie wstrząsnąć puszką (przez minimum 30 s.) w celu dokładnego wymieszania składników. Temperatura puszki przed zastosowaniem kleju powinna wynosić od +10°C do +30°C. Puskę z IZOchem KS przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji 'do góry dnem'. Jeśli prace zostaną przerwane na dłużej niż 15 minut, należy zablokować spust, pozostawiając nakręconą puszkę do następnego użycia.

APLIKACJA:

Mocowanie płyt styropianowych w systemie ETICS

Klej do styropianu nakładamy na płytę warkoczem o średnicy ok. 3 cm z zachowaniem 2 cm odstępu od jej krawędzi i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy zachować ok. 5 cm odstępy między warkoczami (patrz rysunek).



Płyty ocieplające układać naprzemiennie. Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 3 min. (dla 20°C), a następnie przyłożyć do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Ustawienia kolejnych płyt można dokonać po ok. 6 minutach od przyklejenia do ocieplanej powierzchni. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie, kołkowanie). Szczeliny i złącza pomiędzy płytami wypełnić pianą.

Mocowanie płyt styropianowych przy ocieplaniu fundamentów

Pianę na płytę styropianową nakładamy co najmniej czterema pionowymi pasami o szerokości ok. 3 cm z zachowaniem równych odstępów co 20-30 cm między pasami oraz z zachowaniem dystansu 3 cm od krawędzi płyty (dla płyt szerszych niż 1000 mm należy nałożyć więcej pasów). Płyty ocieplające układać naprzemiennie. Po nałożeniu pasów kleju należy odczekać ok. 3 min. (dla 20°C), a następnie przyłożyć do

izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Ustawienia kolejnych płyt można dokonać po ok. 6 minutach od przyklejenia do ocieplanej powierzchni. W narożnikach zastosować dodatkowo podpory do momentu związania kleju (10-15 minut). Szczeliny i złącza pomiędzy płytami wypełnić pianą. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. W strefie cokołowej wymagane jest dodatkowe stosowanie łączników mechanicznych.

Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny należy przeczyszczyć płynem czyszczącym do pistoletów i piany PU IZOCHEM CS. Po pełnym utwardzeniu pianę można usunąć mechanicznie.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Nie stosować piany w przypadku ciągłego narażenia na wodę.

Przed zastosowaniem zapoznać się z Kartą Techniczną wyrobu.

ZUŻYCIE:

- do 12 m² z puszki (fundament)
- do 10 m² z puszki (ETICS)

PRZECHOWYWANIE:

W pomieszczeniach suchych, chłodnych, wyposażonych w wentylację mechaniczną w oryginalnych opakowaniach producenta, **w pozycji pionowej** w temp. +5°C do +35°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 24 miesiące.

OPAKOWANIA: 750 ml

KOLOR: kremowy

DANE TECHNICZNE:

- **Temperatura otoczenia:** od 0°C do +30°C
- **Temperatura podłoża:** od 0°C do +30°C
- **Temperatura puszki:** od +10°C do +30°C
- **Czas korekty:** ok. 5 min (23°C i 50±5% RH)
- **Czas kołkowania:** po ok. 2 godz.
- **Czas pełnego utwardzenia:** po 24 godz.
- **Temperatura przechowywania:** od +5°C do +35°C
- **Gęstość pozorną:** 20 kg/m³±10%
- **Oddziaływanie kleju na styropian w temp. 23°C i 75°C:** brak oznak destrukcji
- **Specyfikacja:** ITB-KOT-2018/0487 wydanie 1

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI (wg ITB-KOT-2018/0487)

przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji):	≤ 11,0 mm	
wytrzymałość na ścinanie:	≥ 85 KPa	
moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu:	≥ 100 KPa	
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, MPa, połączenia EPS spoina klejowa (8 mm) - beton, wykonanego:	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08 MPa
	w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min	≥ 0,08 MPa
	w temperaturze 0 °C	≥ 0,08 MPa
	w temperaturze +30°C i 30% RH	≥ 0,08 MPa
	w warunkach laboratoryjnych, przy modyfikacji grubości spoiny (15 mm)	≥ 0,08 MPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, MPa, połączenia: XPS-spoina klejowa (8 mm)-beton, wykonanego:	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08 MPa
	w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min	≥ 0,08 MPa
	w temperaturze 0 °C	≥ 0,08 MPa
	w temperaturze +30°C i 30% RH	≥ 0,08 MPa
	w warunkach laboratoryjnych, przy modyfikacji grubości spoiny (15 mm)	≥ 0,08 MPa
	w temperaturze +30°C i 30% RH	≥ 0,08 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, MPa, połączenia: XPS lub EPS- spoina klejowa (8 mm) -beton z powłoką bitumiczną, wykonanego w warunkach laboratoryjnych:		≥ 0,08 MPa

UWAGI:

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i niższa wilgotność powietrza opóźniają czas utwardzania kleju. Pokrycia papowe przed klejeniem należy sprawdzić pod kątem osypywania posypki mineralnej. Posypka powinna być trwale zespolona z papą.

Przed przystąpieniem do klejenia zbyt zimną puszkę z klejem należy ogrzać do temperatury pokojowej np. zanurzając puszkę w ciepłej wodzie.